**佛 山 市 优 捷 化 工 有 限 公 司**

**Foshan YouJie Chemical Co.,Ltd**

Plating Additives 电镀添加剂

**CL碱铜光亮剂**

碱铜电镀当作厚铜底时，镀层若能拥有光泽性，则可缩短后来的镀铜或镀镍时间，甚至可直接镀镍，降低成本。而氰化铜镀层本身并不具有平整性及光泽性，因此，若使用CL碱铜光亮剂，则可使厚铜底具有平整、光泽性、降低生产成本。

1. **工艺特性：**
2. 可明显地增进低电流区的深镀能力及镀层均一性。
3. 增加镀层的平滑度与光泽度。
4. 增加PH值与游离氰化钠的操作范围。
5. 可提高电流密度操作及增进镀层的延展性。
6. 增进焊锡性，尤其有助于电子零件的电镀。
7. 可提升镀层的沉积速度，缩短操作时间。
8. 尤其是对于形状复杂的锌合金镀件，可明显地增进低电流区的镀层致密度，使低电流区镀层不易起泡、剥落。

**二、镀液组成及操作条件：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成 份 | 范 围 | 标 准 |
| 氰化铜 | 45-60 g/L | 50 g/L |
| 氰化钠 | 65-90 g/L | 73 g/L |
| 酒石酸钾钠（罗氏盐） | 15-30 g/L | 20 g/L |
| 氢氧化钾 | 10-20 g/L | 15 g/L |
| 碱铜光亮剂CL-3 | 4-8 ml /L | 7 ml /L |
| 碱铜光亮剂CL-4 | 4-6 ml /L | 5 ml /L |
| 温度 | 40-55 ℃ | 50 ℃ |
| PH值 | 11.5-13.0 | 11.5-13.0 |
| 平均电流密度 | 0.2-0.5 A/dm² | 0.2-0.5A/dm² |
| 阳极 | 无氧电解铜 |
| 搅拌 | 空气搅拌 |

**三、消耗量：**

|  |  |
| --- | --- |
| 碱铜光亮剂CL-3 | 100-110ml/1000AH |
| 碱铜光亮剂CL-4 | 300-330 ml/1000AH |

**环保符合性：本产品符合欧盟RoHS指令（2002-95/EC）**